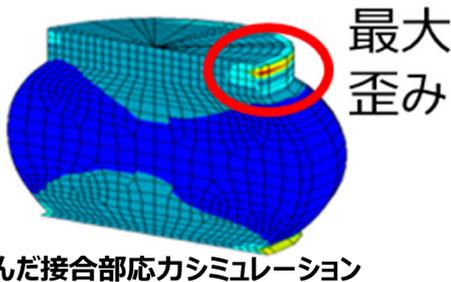


# 接合構造部に着目した寿命解析サービス

パッケージ形態変化(リード⇒BGA)、接続ピッチ狭化、高発熱デバイスの採用など、実装技術の高度化が進むにつれ、設計段階での寿命予測が求められています。多種多様な製品形態における接合構造をメインとした寿命解析を提供。お客様製品の信頼性向上に貢献します。



## ■ 特長

### ・接合構造を意識した寿命解析

単純なはんだ接合部の疲労寿命から、構造体としての環境試験や実使用環境での寿命予測を支援いたします。

### ・現物からの材料物性取得による実動作に近い状態の再現

シミュレーションによる寿命予測精度を上げるため、はんだ材料の他、部品・基板なども含め様々な物性値取得を支援いたします。

### ・設計段階での製品寿命の予測

実機検証前に、設計妥当性確認や、設計手戻りを最小限にするためにシミュレーションを支援いたします。

## ■ サービス詳細

- ・温度サイクル(TC)試験における、はんだ接合部の熱疲労寿命をシミュレーションで予測
- ・基準サンプルで温度サイクル試験と熱応力解析を実施 ⇒ 破壊モードを検証
- ・疲労寿命をはんだ非線形歪振幅の送還から予測式

## ■ 現物サンプルからの材料物性取得、製品寿命検証

